

导热凝胶 Thermal Gel

【 产品用途/Product Usage 】

SE40 是一种柔软的硅树脂基导热缝隙填充材料,具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性,是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间,使其紧密接触、减小热阻,快速有效地降低电子元件的温度,从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE40 可通过手工方式或点胶设备来进行涂装。

【 产品 图 示 Product Illustration 】



【 产品 应用 】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处,不要接触明火。本产品无毒,按非危险品贮存及运输。

【包 装】 ● 30cc ; ● 300cc 。

【有 效 期】 本产品保存期为 6 个月

【安 全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供,但由于我们无法控制产品的使用条件和方法,无法对兼容性的应用提出任何建议,因此这些建议及数据仅供参考,而不作为产品保证。在任何时候,应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前,首先确定我们的材料适用性和建议。

特性参数 SE40		
产品性能	测试结果	测试方法
颜色	粉红色	目视
挤出速度 (30ccEFDcartridges1” orifice 90psi)	30±5g/min	ASTM D2240
密度	3.10g/cm ³	氦气真密度法
最小结合厚度	0.09mm	--
使用温度	-50~150°C	--
阻燃性	V-0	UL 94
溢气	< 0.5%	ASTD E595
体积电阻	>10 ¹² Ω cm	ASTM D257
导热系数	4.0W/m. K	ASTM D5470
热阻 @30psi	0.05°C*in ² /W	ASTM D5470
介电击穿强度	> 5 KV/mm	ASTM D149
介电常数	5.50	ASTM D150
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。注:厚度公差为±10%,硬度公差为±5°,颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。